

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 26 日(26.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/053522 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/62 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/073963
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 18 日(18.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-234182 2010 年 10 月 19 日(19.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田 雅浩 (WADA Masahiro) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 鵜川 健 (UKAWA Ken)

[JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 吉田 顕二 (YOSHIDA Kenji) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 田中 祐介 (TANAKA Yusuke) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外 (ASAHI Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 1 8 番 9 号 西新橋ノアビル 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: SEALING RESIN COMPOSITION AND ELECTRONIC COMPONENT DEVICE

(54) 発明の名称: 封止用樹脂組成物及び電子部品装置

[図2]

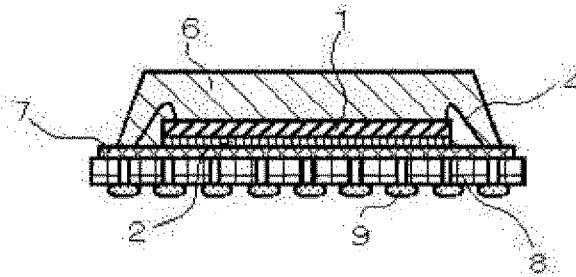


FIG. 2

(57) Abstract: The sealing resin composition of the present invention comprises a phenolic resin curing agent (A), an epoxy resin (B), and an inorganic filler (C). The phenolic resin curing agent (A) comprises: at least one polymer having a predetermined structure; a polymer component (A-1) containing a structure in which a monovalent hydroxyl phenylene structural unit is linked with a multivalent hydroxyl phenylene structural unit by means of a structural unit containing a biphenylene group; and a polymer component (A-2) containing a structure in which multivalent hydroxyl phenylene structural units are linked by means of a structural unit containing a biphenylene group, wherein the phenolic resin curing agent (A) comprises the polymer component (A-1) and the polymer component (A-2) as essential components and comprises at least a predetermined amount of the polymer component (A-1). It is therefore possible to economically provide a sealing resin composition which has excellent balance in terms of soldering resistance, incombustibility, continuous formability, flow characteristics and high-temperature storage characteristics, and to provide a highly reliable electronic component device which is formed by sealing elements with the cured product of the sealing resin composition.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2012/053522 A1